

半導体製造装置フィールドアプリケーションエンジニア（メカ）

TOWA株式会社での募集です。 製造技術（機械）のご経験のある方は歓迎です。

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
TOWA株式会社

Job ID
1625047

Industry
Machinery

Job Type
Permanent Full-time

Location
Kyoto Prefecture

Salary
5 million yen ~ 7 million yen

Work Hours
08:30 ~ 17:30

Holidays
【有給休暇】初年度 10日 1か月目から 年間123日（＋一斉年次有給休暇取得日2日） 週休2日制（基本土日祝、弊社カレンダー…

Refreshed
November 26th, 2026 16:14

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
Business Level

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Technical/Vocational College

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2276576】
半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア（メカ）として、お客様との密なコニュニケーションを通した技術サポートを担っていただきます。具体的には、装置の導入支援や生産時のカスタマイズや技術サポートにおいて、技術的なコミュニケーションを通じて得るお客様のニーズや課題を開発部門にフィードバックし、新製品・新機能の提案を行います。お客様と信頼関係を深め、専門知識や折衝能力を高めることで、将来的にはプロジェクトリーダーや技術スペシャリスト、マネージャーとしてご活躍いただけるステージがございます。

お客様の工場に設置する半導体製造装置の導入支援
お客様のニーズから新しい機能の提案

開発部門へのフィードバック
お客様への技術トレーニングの実施

Required Skills

＜必須＞
自動機（FA）の知見・設計経験・立ち上げ経験のいずれかをお持ちの方
協調性、自主性と責任感があり、チームで成果をあげる働き方に魅力を感じる方
技術英語（初級）
＜歓迎＞
半導体製造装置のフィールドアプリケーションエンジニア経験
装置の設置・調整・トラブルシューティング経験
機械工学、電気電子工学、物理学等の一般知識
技術的な問題解決能力
技術英語（中級以上）
＜求める役割＞
お客様との信頼関係を大切に、お客様のニーズや技術的な課題解決を的確に捉え、粘り強く課題解決に取り組み、最適なソリューションの提供に価値を感じる方。現状に留まることなく常に進化を追求し、新しい知識や技術の習得に意欲的な方。

Company Description

【半導体事業】半導体製造装置（モールディング装置・シンギュレーション装置）・超精密金型の開発・製造・販売【化成品事業】ファインプラスチック成形品の製造・販売【新事業】超精密加工技術をコアとした商品の発売【レーザー事業】レーザー加工装置の販売